

1. CN112743487 - 电子设备的装配方法、电子设备及电子设备的拆卸方法

[National Biblio. Data](#)[Description](#)[Claims](#)[Drawings](#)[Documents](#)[PermaLink](#) [Machine translation ▼](#)**Office**

China

Application Number

201911049383.0

Application Date

31.10.2019

Publication Number

112743487

Publication Date

04.05.2021

Publication Kind

A

IPC

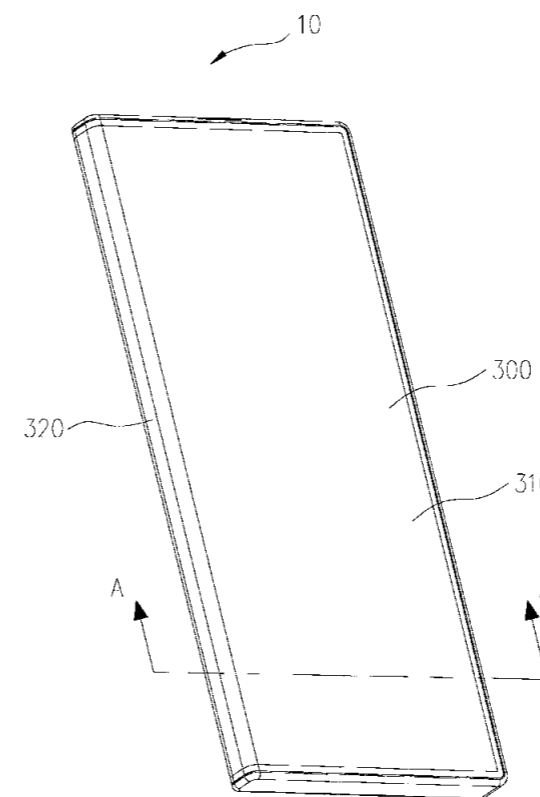
B25B 27/14

Applicants

OPPO广东移动通信有限公司

Inventors王锦涛
姜洋**Agents**

深圳市慧实专利代理有限公司 44480

Title**[ZH]** 电子设备的装配方法、电子设备及电子设备的拆卸方法**Abstract****[ZH]**

本申请实施例提供一种电子设备的装配方法、电子设备及电子设备的拆卸方法。所述电子设备的装配方法包括：提供并排且间隔设置的中框和支架；形成至少部分覆盖所述中框和所述支架的显示组件；将所述中框和所述支架朝向相互靠近的一侧弯折直至相互贴合，以使得所述显示组件位于所述中框和所述支架的外侧。本申请提供的电子设备的装配方法可以使得显示组件较为平整。